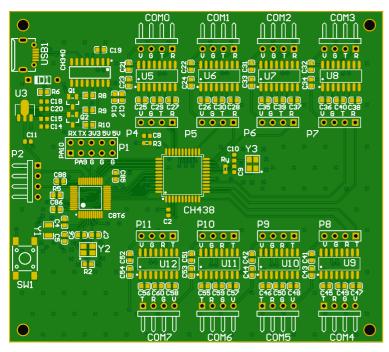


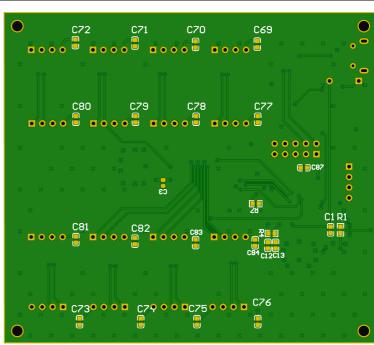
检查报告



时间2022-01-24

文件名: PCB 层数: 4 尺寸: 90.93*80.64 mm





警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议			
焊盘规格	封装内间距异常	有异常	焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致,SMT加工时存在无法焊接的风险			
焊盘规格	焊盘大小异常	有异常	焊盘大小、封装内间距设计与封装规格要求不一致,SMT加工时存在无法焊接的风险			
板边距离	铜/PAD/线到板边距 离	板边异常	外形(板框)用于机械成型,焊盘、铺铜及走线都应避开外形线,避免出现锣断线或器铜的情况。 "铜、焊盘、导线到板间距≥15mil ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			

全部检查项

报告项目 类型

分析结果

孔环	过孔孔环	✓ 正常
	插件孔孔环	✓ 正常
孔到孔	同网络过孔	✓ 正常
	不同网络过孔	✓ 正常
	插件孔	✓ 正常
	过孔到表层	✓ 正常 0.304753 mm
孔到线	插件孔到表层	▼ 正常
	过孔到内层	✓ 正常 0.304753 mm
	插件孔到内层	☑ 正常
	NPTH到铜	☑ 正常
	铜/PAD/线到板边距 离	① 16pis 板边异常
板边距离	SMD到板边距离	☑ 正常
	孔到板边	☑ 正常
特殊孔	半孔	☑ 正常
	盲埋孔	☑ 正常
	盲埋孔距离	☑ 正常
	激光孔	☑ 正常
	正/长方形孔	☑ 正常
焊盘规格	焊盘大小异常	① 5pis 有异常
	封装内间距异常	① 4pis 有异常
孔上焊盘	盘中孔	正常
	插件孔	正常
	过孔上焊盘	正常
	非金属孔	☑ 正常

阻焊开窗	阻焊异常	✓ 正常
	阻焊盖线	✓ 正常
	阻焊间隙	✓ 正常
	同网络阻焊间隙	✓ 正常
	漏阻焊桥	✓ 正常
	同网络漏阻焊桥	✓ 正常
孔密度	孔密度	① 296个; 4.04万/m²
沉金面积	沉金面积	① 14.79%
飞针点数	飞针点数	① 623
Mark点	Mark点	✓ 正常
锣长分析	锣长分析	① 43.3983m/m²